

## Curriculum Vitae Europass

### Informații personale

Nume / Prenume **SVASTA Paul**  
Telefon 0040 21 3169633  
Fax(uri) 0040 21 3169634  
E-mail(uri) paul.svasta@cetti.ro  
Naționalitate(-tăți) română  
Data nașterii 18 a lunii aprilie 1942  
Sex Bărbătesc



### Loc de muncă vizat / Domeniu ocupațional

### Experiența profesională

|  |  |
|--|--|
| Perioada                                     | 1968 →   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Professor  |
| Activități și responsabilități principale    | Educație   |
| Numele și adresa angajatorului               | Catedra de Tehnologie Electronica si Fiabilitate - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB), Bucuresti, Romania |
| Perioada                                     | 2012 →   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Professor emerit   |
| Activități și responsabilități principale    | Educație   |
| Numele și adresa angajatorului               | Catedra de Tehnologie Electronica si Fiabilitate - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB), Bucuresti, Romania |
| Perioada                                     | 2011 →   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Președinte   |
| Numele și adresa angajatorului               | Electronic Innovation Cluster (ELINCLUS), Bucuresti, Romania   |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Cercetare  |
| Dates  | 2011 →   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Membru in Board-ul asociatiei  |
| Numele și adresa angajatorului               | CLUSTERO, Romanian Clusters Association, Bucuresti, Romania  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Cercetare  |
| Perioada                                     | 1999 -2009   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Membru in Consiliu de administratie  |
| Activități și responsabilități principale    | C&D management, Inovare & Transfer Tehnologic  |
| Numele și adresa angajatorului               | Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic (AMCSIT) Bucuresti                      |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Cercetare, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic  |
| Perioada                                     | 1994 – 2007, 2009 →  |

|  |   |
|--|---|
| Funcția sau postul ocupat                    | Vicepresedinte  |
| Numele și adresa angajatorului               | Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software- ARIES  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Industria Electronica   |
| Perioada                                     | 2003 →  |
| Funcția sau postul ocupat                    | Presedinte, membru fondator   |
| Numele și adresa angajatorului               | Asociatia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice- APTE   |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | electronica   |
| Perioada                                     | 2001 - 2005   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Expert (atestat pentru evaluare propuneri proiecte)   |
| Numele și adresa angajatorului               | Ministerul Educatiei si Cercetarii  |
| Perioada                                     | 2001 - 2003   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Presedinte Steering Committee BCUM, program finantat de Banca mondiala  |
| Numele și adresa angajatorului               | Ministerul Educatiei si Cercetarii  |
| Perioada                                     | 1999 - 2000   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Consilierul Presedintelui   |
| Numele și adresa angajatorului               | Agentia Nationala pentru Stiinta si Tehnologie, astazi Ministerul Educatiei si Cercetarii, Bucuresti, Romania   |
| Perioada                                     | 11/1998 - 12/1998   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Bursier DAAD  |
| Activități si responsabilități principale    | Bursa DAAD (German Academic Exchange Service)   |
| Numele și adresa angajatorului               | Technische Universität Darmstadt- Germany   |
| Perioada                                     | 10/1997 - 12/1997   |
| Activități si responsabilități principale    | Cercetare   |
| Numele și adresa angajatorului               | Fraunhofer Institut für Festkoerperstechnologie, München Germania   |
| Perioada                                     | 1982 - 1990   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Director de program   |
| Activități si responsabilități principale    | organizare cursuri si laboratoare la disciplina Tehnologie Electronica, practica in productie   |
| Numele și adresa angajatorului               | IPEE, Curtea de Arges, Romania  |
| Perioada                                     | 1978 - 1982   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Coordonator proiect   |
| Activități si responsabilități principale    | Activități de cercetare dezvoltare în vederea conceperii și realizării de echipamente destinate culegerii, prelucrării și afișării datelor la competițiile sportive |
| Numele și adresa angajatorului               | Ministerul Tineretului si Sportului   |
| Perioada                                     | 1973 - 1974   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Bursier DAAD (German Academic Exchange Service)   |
| Numele și adresa angajatorului               | Technische Universität München, Institut für Nachrichtentechnik, Munich, Germany  |
| Perioada                                     | 1971 - 1973   |
| Funcția sau postul ocupat                    | Sef sectie  |
| Activități si responsabilități principale    | practica productiva a studentilor   |
| Numele și adresa angajatorului               | Uzina "ELECTRONICA", Bucharest, Romania   |

## Educație și formare

|  |   |
|--|---|
| Perioada   | 1981  |
| Calificarea/diploma obținută   | Dr.ing.   |
| Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite | circuite electronice  |
| Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare    | Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Romania  |
| Perioada   | 1963 - 1968   |
| Calificarea/diploma obținută   | Licenta si Master   |
| Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite | Electronica si Telecomunicatii  |
| Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare    | Facultatea de Electronică și Telecomunicații- Universitatea "Politehnica" din București, Romania  |
| Perioada   | 1960 - 1962   |
| Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare    | Școala militară superioară de ofițeri Sibiu, specialitatea Transmisiuni (Școala militară superioară de ofițeri Sibiu, specialitatea Transmisiuni) |
| Perioada   | 1956 - 1960   |
| Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare    | Liceul militar "Mihai Viteazu", Galați (Liceul militar "Mihai Viteazu", Galați)   |

## Aptitudini și competențe personale

Limba maternă **Romana**

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare  
Nivel european (\*)

**Engleză**

**Germană**

**Maghiară**

| Înțelegere |                         |        |                         | Vorbire                    |                         |              |                         | Scriere |                        |
|------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| Ascultare  |                         | Citire |                         | Participare la conversație |                         | Discurs oral |                         |         |                        |
| C1         | Utilizator experimentat | C1     | Utilizator experimentat | B1                         | Utilizator independent  | B1           | Utilizator independent  | B1      | Utilizator independent |
| C1         | Utilizator experimentat | B2     | Utilizator independent  | C2                         | Utilizator experimentat | C2           | Utilizator experimentat | B1      | Utilizator independent |
| B2         | Utilizator independent  | A1     | Utilizator elementar    | B1                         | Utilizator independent  | A2           | Utilizator elementar    | A1      | Utilizator elementar   |

(\*) [Cadrlui european comun de referință pentru limbi](#)

Competențe și abilități sociale

Spirit de echipa, abilitate de adaptare la medii multi-culturale obtinuta in urma colobararilor cu parteneri internationali.

Abilitati de comunicare obtinute prin participare ca presedinte si co-presedinte la conferinte internationale.

Activitati de networking pentru implicarea universitatilor romanesti in activitati de cercetare si educatie dedicate packagingului electronic si microsystemelor.

Competențe și aptitudini organizatorice

Bun organizator, experienta in managementul de proiect fiind conducatorul unei echipe de 20 de specialisti.

Initiator (1992) si director al Concursului National Studentesc TIE (Tehnici de Interconectare in Electronica) [www.tie.ro](http://www.tie.ro), coordonator a unui mare numar de proiecte de cercetare.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Dezvoltarea si implementarea unui program de pregatire pentru studenti in cadrul unei companii de componente de electronice pasive (Curtea de Arges). Mai mult de 3000 de studenti au beneficiat de acest program.</p> <p>Dezvoltarea si implementarea unor evenimente cu un caracter tehnic (simpozioane, workshopuri, conferinte) focalizate pe tehnologia electronica, inclusiv asamblarile tehnologice.</p> |
| Competențe și aptitudini tehnice                       | <p>O buna cunoastere a proceselor de control a calitatii.</p> <p>Responsabil cu implementarea sistemului managerial ISO 9001.</p> <p>O buna experienta in tehnologia straturilor groase castigata pe perioada unei burse DAAD in Fraunhofer IFT Munich, Germania.</p> <p>Conducator de doctorat in domeniul packaging-ului electronic.</p>   |
| Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului | <p>Cunostinte in Microsoft Office (Word, Excel and Power Point).</p> <p>Dezvoltarea sistemului de invatare cu ajutorul calculatorului; introducerea platformelor multimedia si e-learning in continutul cursului clasic.</p>   |
| Competente si aptitudini artistice                     | <p>Senior editor pentru reviste tehnice (Electronica Azi – Electronics Today; EP&amp;Dee – Electronic Products &amp; Design Eastern Europe)</p> <p>Editor pentru seria de cărți de Electronic Packaging</p>  |
| Alte competențe și aptitudini                          | <p>Membru in organizatii profesionale si non-profesionale (IEEE, IMAPS, IPC, FLUIDAS)</p>  |
| Anexe  | <p>Anexa 1 - Lista de lucrări publicate</p> <p>Anexa 2 - Experiența acumulată în programe naționale/internaționale</p> <p>Anexa 3 - Membru al asociatiilor profesionale</p> <p>Anexa 4 - Alte mentiuni</p>   |

**Lista de lucrări publicate (2012-2018)**  
**Prof. PAUL SVASTA, Ph.D.**

1. **P. Svasta**, N.D. Codreanu, Requirements of Industry for the Education of Printed Circuit Board Designers, 20 FED Konferenz, "Elektronik-Design-Leiterplatten-Baugruppen 2012", Dresden 20-22 sept. 2012, pp 155-164
2. D. Bonfert, N. Codreanu, P. Svasta, C. Ionescu, Optimization of a Heater Geometry for Flexible Gas Sensor Applications, 36th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2013: Automotive Electronics, May 8 – 12, 2013, Alba Iulia, Romania
3. D. Bonfert, D. Hemmetzberger, G. Klink, K. Bock, C. Ionescu, P. Svasta, Electrical Stress on Transparent Conductive Oxide Layer, 36th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2013: Automotive Electronics, May 8 – 12, 2013, Alba Iulia, Romania
4. M. Pantazica, C. Marghescu, C. Tamas, H. Wohlrabe, K. Wolter, P. Svasta, Evaluation of the Effects of the Layout Design on the Quality of SMT Boards, 36th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2013: Automotive Electronics, May 8 – 12, 2013, Alba Iulia, Romania
5. M. Brânzei, I. Pencea, I. Plotog, M. Branzei, A. Bibis, P. Svasta, Multiconvolutional Approach for Uncertainty Estimation of the Thermal Diffusivity Measured by Flash Method, 36th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2013: Automotive Electronics, May 8 – 12, 2013, Alba Iulia, Romania
6. B. Mihailescu, I. Plotog, **P. Svasta**, C. Marghescu, „Modeling and Simulation of Inductive Structures for Non-Invasive Medical Uses”, Conference proceedings 2013 IEEE 19th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages (SIITME), pp. 167-170, IEEE eXplore DOI: 10.1109/SIITME.2013.6743666, ISBN: 978-1-4577-1275-3, Galați, România, Octombrie 2013
7. F. Draghici, M. Pantazica, N. Codreanu, **P. Svasta**; Hands-on Project – Key Issue in the Education of Future Electronic Engineers, 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE 2014, May 7-11, 2014, Dresda, Germany
8. A. Marghescu, **P. Svasta**, T. Neacsu; Cryptographic Coprocessor for Data Integrity Algorithms, 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE 2014, May 7-11, 2014, Dresda, Germany.
9. Bogdan Mihailescu, **Paul Svasta**, Alexandru Borcea, „*ELINCLUS Cluster - Bridge between Academia and Industry as an Innovation Accelerator*”, Conference proceedings 38th International Conference of IMAPS-CPMT Poland (IMAPS-CPMT 2014), Rzeszów - Czarna, 21-24 September 2014
10. Paul Svasta, Layout Design of Printed Circuits Boards – An Important Issue of the 21st Century Undergraduate Electronics Curricula, 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszow-Czarna, 21-24 september 2014, Rev. Elektronika nr. 3/2015, ISSN 0033-2089, pg. 46-49
11. E. SENYUREK, Zs. ILLYEFALVI-VITÉZ, **P. SVASTA**, and A. PIETRIKOVA, E. ORUN, Virtual and Practical Applications to Electronic Assembling Technology, 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, IEEE eXplore DOI: 10.1109/SIITME.2014.6967033, ISBN: 978-1-4577-1275-3, Bucharest, România, Octombrie 2014
12. N. Bădălan, **P. Svasta**, Thermo-Electric Cooler for Power LEDs, 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, IEEE eXplore DOI: 10.1109/SIITME.2014.6967033, ISBN: 978-1-4577-1275-3, Bucharest, România, Octombrie 2014
13. A. Marghescu, G. Teseleanu, D.-S. Maimut, T. Neacsu and **P. Svasta**, Adapting a Ring Oscillator-based True Random Number Generator for Zynq System on Chip Embedded Platform, 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, IEEE eXplore DOI: 10.1109/SIITME.2014.6967033, ISBN: 978-1-4577-1275-3, Bucharest, România, Octombrie 2014
14. A. Marghescu, G. Teseleanu, and **P. Svasta**, Cryptographic Key Generator Candidates based on Smartphone built-in Sensors, 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, IEEE eXplore DOI: 10.1109/SIITME.2014.6967033, ISBN: 978-1-4577-1275-3, Bucharest, România, Octombrie 2014
15. C. Ropoteanu, **P. Svasta**, C. Ionescu, Planar Windings Design Analysis regarding Power Transfer Aspects of a Ferrite Core Planar Transformer in the MHz Region, 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, IEEE eXplore DOI: 10.1109/SIITME.2014.6967033, ISBN: 978-1-4577-1275-3, Bucharest, România, Octombrie 2014
16. A. Rizoiu, S. Enache, M. Varlam, and **P. Svasta**, A Fundamental Study of Supercapacitive Cells, 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, IEEE eXplore DOI: 10.1109/SIITME.2014.6967033, ISBN: 978-1-4577-1275-3, Bucharest, România, Octombrie 2014
17. N. Bădălan, **P. Svasta**, Peltier Elements vs Heat Sink in Cooling of High Power Leds, 38<sup>th</sup> International Spring Seminar on Electronics Technology "Novel Trends in Electronics Manufacturing", Eger, Hungary, May 6-10, 2015
18. M. Branzei, G. Varzaru, **P.M. Svasta**, Shear Strength Function of Temperature for Lead/Lead-Free Alloys Samples Obtained with Different Cooling Rate, 38<sup>th</sup> International Spring Seminar on Electronics Technology "Novel Trends in Electronics Manufacturing", Eger, Hungary, May 6-10, 2015

19. A. Marghescu, **P. Svasta**, E. Simion, Randomness Extraction Techniques for Jittery Oscillators, 38<sup>th</sup> International Spring Seminar on Electronics Technology "Novel Trends in Electronics Manufacturing", Eger, Hungary, May 6-10, 2015
20. A. Botau, D. Bonfert, C. Negrea, **P. Svasta**, C. Ionescu, Electro-Thermal Analysis of Flexible Micro-Heater, 38<sup>th</sup> International Spring Seminar on Electronics Technology "Novel Trends in Electronics Manufacturing", Eger, Hungary, May 6-10, 2015
21. B. Mihailescu, **P. Svasta**, C. Marghescu, A. Borcea, Clusters as a Catalyst for Developing Human Resources for the Internet of Things Industry, 38<sup>th</sup> International Spring Seminar on Electronics Technology "Novel Trends in Electronics Manufacturing", Eger, Hungary, May 6-10, 2015
22. Niculina Badalan, **Paul Svasta**, F. Drăghici, CONSTANT CURRENT VERSUS PULSE CURRENT FOR POWER SUPPLIES ON HIGH POWER LED, 2015 IEEE 21st International Symposium for Design and Technology of Electronics Packaging (SIITME), Brasov, Romania, 22-25.10.2015, PP. 263 – 266
23. R. Negroiu, **P. Svasta**, Al. Vasile, C. Ionescu, C. Marghescu, Comparison between Zubieta Model of Supercapacitors and their Real Behavior, 22nd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging 20-23 October, 2016 Baile Felix, Oradea, Romania
24. Supercapacitors - an Alternative Electrical Energy Storage device, By: **Svasta, P.**; Negroiu, R.; Vasile, Al., Conference: 5th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE) Location: Galati, ROMANIA Date: OCT 20-22, 2017, 2017 5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (ISEEE) Book Series: International Symposium on Electrical and Electronics Engineering Published: 2017
25. Maintenance-free IOT Gateway Design for Bee Hive Monitoring, By: Vidrascu, M. G.; **Svasta, P. M.**, 2017 IEEE 23RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR DESIGN AND TECHNOLOGY IN ELECTRONIC PACKAGING (SIITME) Pages: 183-187 Published: 2017
26. Vasile, A. ; Codreanu, N. ; Dima, M. ; Ionescu, C. ; Negroiu, R. ; **Svasta, P.** s.a. "Fast Control System and Algorithms for Stabilizing of Mobile Platforms" , 2018 41ST INTERNATIONAL SPRING SEMINAR ON ELECTRONICS TECHNOLOGY (ISSE), IEEE : International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE Published: 2018, Conference: 41st International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE) Location: Zlatibor, SERBIA, Date: MAY 16-20, 2018 Accession Number: ISBN:978-1-5386-5731-7; 978-3-319-73847-5, ISSN: 2161-2536
27. Methods for Determining the Leakage Current of Supercapacitors, By: Negroiu, R.; **Svasta, P.**; Vasile, Al.; et al., Conference: 41st International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE) Location: Zlatibor, SERBIA Date: MAY 16-20, 2018, 2018 41ST INTERNATIONAL SPRING SEMINAR ON ELECTRONICS TECHNOLOGY (ISSE) Book Series: International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE Published: 2018
28. D.C. Vasile, **P. Svasta**, Innovative Conductive Mesh Structure for the Protection of Security Electronic Circuits, Electronics System-Integration Technology Conference, Dresden, 2018.
29. Rodica Negroiu; **Paul Svasta**; Alexandru Vasile; Ciprian Ionescu; Popescu Ileana Iulia, The Performance of Supercapacitors' Main Parameters According to Topology of the Electrical Circuits in Which They are Used Publication Year: 2018, Page(s):187- 190, Date of Conference: 25-28 Oct. 2018, Date Added to IEEE Xplore: 03 January 2019, ISBN Information: Publisher: IEEE, Conference Location: Iasi, Romania
30. Monica Ciolacu, Ali Fallah Terhani, Leon Binder, **Paul Svasta**: "Education 4.0 - Artificial Intelligence assisted higher Education: Early recognition System with Machine Learning to support Students Success", SIITME 2018, IEEE Conference and Symposium, accepted for oral session, 2018. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8599203>, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1, Page 23-30
31. D.C. Vasile, **P. Svasta**, Antitamper Conductive Mesh Used for Securing Cryptographic Modules, 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, 2018.
32. Rodica Negroiu; **Paul Svasta**; Alexandru Vasile; Ciprian Ionescu; Popescu Ileana Iulia, The Performance of Supercapacitors' Main Parameters According to Topology of the Electrical Circuits in Which They are Used Publication Year: 2018, Page(s):187- 190, Date of Conference: 25-28 Oct. 2018, Date Added to IEEE Xplore: 03 January 2019, ISBN Information: Publisher: IEEE, Conference Location: Iasi, Romania
33. Monica Ciolacu, Ali Fallah Terhani, Leon Binder, **Paul Svasta**: "Education 4.0 - Artificial Intelligence assisted higher Education: Early recognition System with Machine Learning to support Students Success", SIITME 2018, IEEE Conference and Symposium, accepted for oral session, 2018. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8599203>, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1, Page 23-30
34. D.C. Vasile, **P. Svasta**, Antitamper Conductive Mesh Used for Securing Cryptographic Modules, 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, 2018.
35. Ciprian Ionescu, Alexandru Vasile, **Paul Svasta**, Norocel Codreanu, Mihai Jurbă, Gheorghe Marin, Comparative Performance Analysis of Dye Sensitized Solar Cells, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packaging (SIITME), Cluj Napoca, Romania, 23-26.10.2019, Page 3
36. Madalin Vasile Moise, Paul Svasta and Laurentiu Mihai Ionescu, Implementation of a prototype air quality measurement system using MEMS sensors, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packaging (SIITME), Cluj Napoca, Romania, 23-26.10.2019, Page 23

37. D. C. Vasile, P. M. Svasta, M. Pantazică, Preventing the Temperature Side Channel Attacks on Security Circuits, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packaging (SIITME), Cluj Napoca, Romania, 23-26.10.2019, Page 85
38. D. C. Vasile, P. M. Svasta, Protecting the Secrets: Advanced Technique for Active Tamper Detection Systems, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packaging (SIITME), Cluj Napoca, Romania, 23-26.10.2019, Page 87
39. C. Cherciu, A.N. Croitoru, P.M. Svasta and D.I. Nastac, Analysis of Real Time Corrections for a Global Navigation Satellite System Ground Station, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packaging (SIITME), Cluj Napoca, Romania, 23-26.10.2019, Page 105
40. Florin Berinde, Aurelian Kotlar, and Paul Svasta, Parametric Filter Design for Conducted Emissions, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packaging (SIITME), Cluj Napoca, Romania, 23-26.10.2019, Page 123
41. C. Ropoteanu and P. Svasta, Effects of Excitation Waveform on Developing Planar Core Transformers, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packaging (SIITME), Cluj Napoca, Romania, 23-26.10.2019, Page 135
42. N. Bădălan (Drăghici), P. Svasta, C. Marghescu, Thermal Model for LED Luminaire, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packaging (SIITME), Cluj Napoca, Romania, 23-26.10.2019, Page 147
43. Monica Ciolacu, Leon Binder, Paul Svasta, Ioan Tache, Dan Stoichescu, Education 4.0 - Jump to Innovation IoT in Higher Education, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packaging (SIITME), Cluj Napoca, Romania, 23-26.10.2019, Page 191

#### Lista tratatelor, monografiilor, manualelor publicate

1. Svasta P. et al., Passive electronic components and circuits (Componente si circuite passive), UPB 1998, application selection, coordination and pp. 3-21, 89-108;
2. Svasta P. et al., Elements of computer aided design of electronic modules (Elemente de proiectare asistata de calculator a modulelor electronice), UPB 1998, coordination 5-11, 160-165;
3. Svasta P. et al. Computer aided design of electronic modules (Proiectarea asistata de calculator a modulelor electronice), editor and coordination, "Tehnica" Publishing House 1998;
4. Svasta P., I. Cristea, Interconnection technologies through surface mount technologies (SMT) of electronic components (Tehnologiile de interconectare prin montarea pe suprafata (SMT) a componentelor electronice), UPB, ISBN 973-0-00888-4;
5. Svasta P., Golumbeanu V., Passive electronic components and circuits - Resistors (Componente și circuite pasive – Rezistoare), UPB 2000;
6. Svasta P., Golumbeanu V. et al., Up-to-date passive electronic components packaging (Noutăți în packagingul componentelor electronice pasive), "Politehnica Press" Publishing House - Bucharest, 2001, ISBN 973-85237-2-9;
7. Svasta P., Golumbeanu V. et al., Elements of electronic module packaging (Elemente de packaging al modulelor electronice), PrinTech Publishing House – Bucharest, ISBN 973-652-622-4;
8. Svasta P., Golumbeanu V., Ionescu C., Fleșchiu A., Moraru D., Codreanu N. D., Leonescu D., *Passive electronic components – applications ("Componente electronice pasive - probleme")*, Cavallioti Publishing House -Bucharest, 2004, 208 pages;
9. Svasta P., Golumbeanu V., Ionescu C., Vasile A., *Passive electronic components – Resistors ("Componente electronice pasive - Rezistoare")*, Cavallioti Publishing House -Bucharest, 2005, 327 pages, ISBN 973-9463-93-2;
10. Svasta P., Golumbeanu V., Ionescu C., Fleșchiu A., Moraru D., Codreanu N. D., Leonescu D., *Passive electronic components – applications ("Componente electronice pasive - probleme")*, Cavallioti Publishing House -Bucharest, 2007, 208 pages, ISBN 973-9463-74-6;
11. Svasta P., Golumbeanu V., Ionescu C., Vasile A., *Passive electronic components – Resistors –Properties, Structure, Technology, Applications ("Componente electronice pasive – Rezistoare - Proprietăți, Construcție, Tehnologie, Aplicații")*, Cavallioti Publishing House -Bucharest, 2007, 337 pages, ISBN 978-973-7622-39-6.

#### Lista brevetelor de invenție:

1. SVASTA P, NICOLESCU I, DRAGOMIRESCU M, SOFRON E, STAICULESCU S, SCHIOPU P, DRAGOMIRESCU O, COLUMBEANU V, „Automatic monitor of electric power points - has programmed individual supply and fault detector circuits, microcomputer and real time analyser”, Patent Number(s): RO104660-A, International Patent Classification: G07C-003/02

#### Patent Details:

| Patent Number | Publ. Date  | Main IPC    | Week   | Page Count | Language |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|----------|
| RO104660-A    | 30 Aug 1995 | G07C-003/02 | 199617 | Page: 1    |          |

2. Vasile Cătuneanu, Vasile Corlățeanu, Marin Drăgulescu, Marieta Dragomirescu, Ioan Nicolescu, **Paul Svasta**, Ovidiu C. Dragomirescu, „**System for information transmission in sports competitions**”, patent no. 73337/11.06.1979
3. Vasile Cătuneanu, Vasile Corlățeanu, Marin Drăgulescu, Ovidiu C. Dragomirescu, Marieta Dragomirescu, **Paul Svasta**, Ioan Nicolescu, „**Display box with thyristor memory**”, patent no. 77479/29.05.1981



**Experiența acumulată în programe naționale/internaționale:**

| Programul/Proiectul  | Funcția                                    | Perioada: |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  |           |      |
| "Mediu tehnologic destinat automatizării proiectării electronice", contract de cercetare UPB-MCT, nr. 572B/15B   | Director de proiect                        | 1994      | 1997 |
| "Bază de cercetare cu utilizatori multipli BCUM", cod CNCSU 42   | Director de proiect                        | 1996      | 2000 |
| "Establishment of Low Cost Mulchip Modules in Benefit of European Industry", contract de cercetare INCO- COPERNICUS, (UPB-UE) nr. PL 964343  | Responsabil de proiect - Partener          | 1996      | 1999 |
| "Crearea de biblioteci-baze de date destinate proiectării asistate de calculator", contract de cercetare UPB-MCT, nr. 836/B18  | Director de proiect                        | 1997      |      |
| "Dezvoltare segment de proiectare asistată pentru module multicip (MCM)", contract de cercetare UPB-MCT, nr. 836/B32   | Director de proiect                        | 1997      | 1998 |
| "Educație inovatoare în colegii privind tehnologiile de interconectare prin montarea pe suprafață (SMT) a componentelor electronice", cod CNFIS 65   | Director de proiect                        | 1997      | 2000 |
| "Cercetări complexe asupra funcționării și realizării cu costuri reduse a modulelor electronice <Institut virtual> suport pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) - VIREPI", Cod CNCSIS 23   | Director de proiect                        | 1998      | 2000 |
| "Integrarea proiectării intradisciplinare în mediul CAD din electronică" cod CNCSU 77  | Director de proiect                        | 1998      | 1999 |
| BCUM – Compatibilitatea electromagnetică a modulelor electronice. Program TICEM, Program Major   | Director de proiect                        | 1998      | 2002 |
| Tehnologii ecologice alternative de contactare a componentelor SMD   | Director de proiect                        | 1998      | 2002 |
| Modelarea, simularea și experimentarea structurilor rezistive pe substraturi alternative PCB/MCM   | Director de proiect                        | 2000      |      |
| Program PHARE RO 9602 TTQM: KNOW-HOW TRANSFER FOR POWER SUPPLY MODULES   | Partener                                   | 2000      | 2002 |
| Aplicarea metodelor și tehnicilor noi de modelare și simulare a sistemelor electrohidraulice de reglare a presiunii în vederea testării virtuale   | Director de proiect                        | 2001      | 2003 |
| Cercetări privind managementul termic în domeniul packagingului electronic   | Director de proiect                        | 2001      | 2003 |
| CERCETĂRI PRIVIND TRANSFERUL TERMIC LA CONECTAREA COMPONENTELOR SMD PRIN RETOPIRE  | Director de proiect                        | 2001      |      |
| Contract RELANSIN CENTRU DE EXCELENȚĂ: CENTRUL DE ELECTRONICĂ TEHNOLOGICĂ ȘI TEHNICI DE INTERCONECTARE Nr. 1333/2001   | Director de proiect, apoi membru în echipă | 2001      | 2004 |
| Contract RELANSIN PROGRAM DE DISEMINARE A CUNOȘTIINȚELOR ȘI REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN INGINERIA PACKAGINGULUI ELECTRONIC Nr. 1060/2001  | Director de proiect, apoi membru în echipă | 2001      |      |
| Program Cadru 5: IST Programme (EASIT) – 1999/10712 ENHANCED ACCES TO SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGIES  | Partener                                   | 2001      | 2002 |
| Proiect pilot dispecerat pentru monitorizare/ supraveghere/ comunicații destinat vehiculelor pentru transportul urban de persoane 1C03/AMTRANS   | Director de proiect                        | 2001      | 2003 |
| Programul CALIST: "DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA ȘI CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII CONFORM CU STANDARDUL SR EN ISO 9001:2001 ÎN CENTRE DE CERCETARE DIN MEDIUL UNIVERSITAR TEHNIC", contract de finanțare nr. 4402 din data de 31.07.2003 | Director de proiect                        | 2003      |      |

|  |                                   |      |      |
|--|-----------------------------------|------|------|
| Programul Societatea Informațională – INFOSOC C4, cu titlul “Mediu tehnologic integrat destinat dezvoltării de module electronice performante pentru comunicații și lucru colaborativ în societatea informațională”, Contract de finanțare nr. 102/17.09.2003            | Director de proiect               | 2003 | 2005 |
| Proiect bilateral <b>ROMANIA-SLOVENIA</b> „Aspecte electromagnetice, electromecanice și termice în realizarea subsistemelor electronice hibride” contractului nr. 102 din 17.09.2003   | Responsabil de proiect            | 2003 |      |
| Proiect bilateral <b>ROMANIA-UNGARIA</b> “Modelarea, Simularea și Testarea Modulelor Electronice”  | Responsabil de proiect            | 2003 |      |
| Proiect de Ofertă MicroElectronică Tehnologică în Universitate – PROMETEU, proiect INFRATECH, contr. nr. 14/08.11.2004   | Director de proiect               | 2004 | 2005 |
| CEEX - CERCETARI PRIVIND INOVAREA SI OPTIMIZAREA ECHIPAMENTELOR SI SISTEMELOR HIDRAULICE UTILIZAND CONCEPTE MECATRONICE, MODELAREA MATEMATICA SI SIMULAREA NUMERICA IN SCOPUL CRESTERII PERFORMANTELOR   | Partener                          | 2005 | 2007 |
| CEEX - Cercetări privind elaborarea unor tehnologii mecatronice integrate pentru măsurători complexe de parametri ai proceselor de producție, destinate utilajelor hidropneumatice   | Partener                          | 2005 | 2007 |
| CEEX - CREAREA UNEI STRUCTURI DE DISEMINARE A CERCETARII ROMANESTI IN DOMENIUL HIDRAULIC PNEUMATIC MECATRONIC MASINILOR AGRICOLE PENTRU CRESTEREA VIZIBILITATII SI INTEGRARII ACESTUIA IN UNIUNEA EUROPEANA  | Responsabil de proiect - Partener | 2005 | 2007 |
| „Sistem multimedia Remix Games Board”  | Responsabil de proiect            | 2006 |      |
| IN-TECH TRANSFER: Integrarea resurselor din institute de cercetare si universitati intr-o retea moderna bazata pe TIC, cu scopul sprijinirii inovarii, transferului tehnologic si accesarii Programului "Competitivitate si Inovare", strategia Lisabona 2007-2013, CEEX | Membru în echipa - CO             | 2006 | 2008 |
| RETEA STIINTIFICA SI PLATFORMA TEHNOLOGICA ECOLOGICA PENTRU PACKAGINGUL ELECTRONIC - RESPLATEPE, CEEX, AMTRANS   | Responsabil de proiect - Partener | 2006 | 2008 |
| ELECT2EAT – E-Learning Education and Continuing Training to Electronics Assembling Technology - Lifelong Learning Programme 2007-2013 Leonardo da Vinci  | Responsabil de proiect - Partener | 2007 | 2013 |
| Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare a IMM-urilor - INNOINDEX   | Membru în echipa                  | 2007 | 2010 |
| Radiometre Miniaturale Neutronice/Gamma cu Corp Solid destinate Radioprotectiei, Monitorizarii Mediului si Combaterii Traficului de Substante Radioactive” (RMNGCS)  | Membru în echipa                  | 2007 | 2010 |
| Sistem bioanalitic pentru detectia reziduurilor pesticidelor din matrici complexe de alimente SCREENFOOD   | Membru în echipa                  | 2007 | 2010 |
| Sistem modular de sensori optoelectronici pentru achizitie, transmitere si prelucrare a imaginilor in domeniul vizibil si IR - OPTELLA   | Membru în echipa                  | 2007 | 2010 |
| Proiect bilateral <b>ROMANIA-SLOVENIA</b> , Dezvoltarea de senzori si traductoare de presiune avansate   | Responsabil de proiect            | 2008 | 2009 |
| Proiect bilateral <b>ROMANIA-UNGARIA</b> , Investigarea micromodulelor electronice conforme „ROHS” bazate pe metode de eficiență energetică,   | Responsabil de proiect            | 2008 | 2009 |
| Advanced Solder Materials for High Temperature Application (HISOLD)  | Responsabil de proiect - Partener | 2009 | 2011 |
| e-Training Microsystems Technologies – mSysTech, Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci   | Membru în echipa - CO             | 2009 | 2010 |

|   |                                   |      |      |
|---|-----------------------------------|------|------|
| Promovarea culturii antreprenoriale adaptabilitate dinamism, initiativa in industria electronica, FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  | Manager proiect                   | 2009 | 2011 |
| NoE FlexNet - Network of Excellence for building up Knowledge for improved Systems Integration for Flexible Organic and Large Area Electronics (FOLAE) and its exploitation   | Responsabil de proiect            | 2010 | 2012 |
| „Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apa, nutrienti si pesticide, in vederea cresterii competitivitatii tehnico-economice a fermelor legumicole mici si mijlocii (SIOPTEF)”, PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-899: Nr. 121/2012 | Membru în echipa                  | 2012 | 2014 |
| Familie de lunete de ochire tactice cu factor zoom mare (LUTAZ) - Programul INOVARE, Subprogramul Dezvoltare-Produse-Sisteme-Tehnologii, CONTRACT DE FINANTARE NR.3 DPST / 20.08.2013   | Membru în echipa                  | 2013 | 2015 |
| Virtual And Practical Applications to Electronic Assembling Technology (VAPAEAT), <b>Project Number</b> : 2013-1-TR1-LEO05-47531  | Membru în echipa                  | 2013 | 2015 |
| eDIGIREGION: Realising The Digital Agenda Through Transnational Cooperation between Regions, Project Number: 319913   | Responsabil de proiect - Partener | 2013 | 2015 |
| ”Entitate Suport Colaborativ Avansat pentru Inovare de Produse și Servicii - ESCA-IPS”, Cod SMIS: 49741   | Membru în echipa                  | 2014 | 2015 |
| Structură Managerială pentru un Ambient Robust, Tehnologic și Inovativ  | Membru în echipa – CO             | 2018 | 2020 |
| Integrated Development 4.0 (iDev40)   | Responsabil de proiect - Partener | 2019 | 2021 |

**Membru al asociațiilor profesionale:**

- IEEE- senior member(2006)
- CPMT – RO –HU Joint Chapter – Junior past Chair
- IEEE-CPMT Student Branch Chapter - Advisor
- IEEE - Educational Society, member
- IEEE – EMC Romanian Chapter
- IMAPS -secțiunea germană, member
- IMAPS USA, member
- IPC - member
- International Microelectronics and Packaging Society SUA, membru fondator
- AFCEA – membru, președintele secțiunii de electronică
- OE-A – membru
- ELINCLUS - ELectronic INnovation CLUSter, Bucharest, Romania - President
- CLUSTERO, Romanian Clusters Association, Bucharest, Romania – Member of the board

*Face parte din comitetele:*

- de organizare a Conferinței Internaționale Electronic Systemintegration Technology Conference, Presedintele Subcomitetului de Componente pasive ;
- European Liason Committee al IMAPS Europe
- de organizare a Seminarului International Spring Seminar on Electronic Technology Dresda, Budapesta, Wroslaw, Sofia, Viena, București, Praga, Bratislava ISSE-membru al Comitetului Director;
- de redacție a revistei Acta Tehnica Napocensis Electronics andTelecommunications - membru;
- de organizare a Simpozionului Internațional Microelectronics Technology and Microsystems MTM, Polonia, Ucraina, Slovacia, Germania Romania membru in Comitetul stiintific (1998-2002);
- de organizare a conferintei internaționale SIITME ([www.siitme.ro](http://www.siitme.ro)) –copreședinte si fondator științific al Institutului de cercetări pentru hidraulică și pneumatică.

*Membru al:*

- Membru fondator și vicepreședinte al Societății SOFDAAD 1994
- Membru al Societății Române pentru Inginerie Concurentă
- Membru al Asociației pentru Compatibilitate Electromagnetică din România, ACER, 2001
- Membru al Asociației Naționale pentru Criptografie, 1998
- Membru fondator și Președinte al Asociației pentru Promovarea Tehnologiei Electronice, APTE
- Membru în Consiliul Științific al Centrului Național de Tehnologia Informației
- Vicepreședinte al Asociației Române pentru Industrie Electronică și Software- ARIES

**Alte mentiuni:**

- Distincții* - Premiul AGIR pe 1998 pentru lucrarea “Proiectarea asistata de calculator a modulelor electronice”, editor si coordonator, Editura Tehnica **1998**
- Ordinul Național „Serviciu Credincios” în grad de ofițer. 2000
  - Diploma de Centru de Excelență acordată de către Ministerul Educației și Cercetării, 2001
  - IEEE-CPMT Society, 2003 Best Student Branch Chapter of the Year Award, Paul Svasta, Advisor,
  - Certificate of Achievement acordat in ianuarie 2004 de IEEE Sectiunea Romania
  - Diploma de Excelență acordata de ARIES pentru promovarea studenților și implicarea lor în activități de cercetare-dezvoltare, 2004
  - Autorizarea în martie 2004, în cadrul UPB-CETTI, a Incubatorului Tehnologic și de Afaceri: CETTI-ITA ca entitate in structura ReNITT (Rețeaua Nationala de Inovare si Transfer Tehnologic
  - **24 februarie 2012 – Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Cluj Napoca**
  - **29 aprilie 2014 - Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești**

• Începând cu 1990 activitatea de cercetare a adâncit problematica utilizării calculatoarelor în activitățile de proiectarea și realizare a modulelor electronice. A fost constituit Centrul de Electronica Tehnologica și Tehnici de Interconectare-CETTI. In cadrul centrului s-au pus bazele unui mediu ce să permită automatizarea proiectării, s-au procurat programe performante destinate activităților CAD-CAM-CAE, inclusiv a celor ce vizează analiza termica și de fiabilitate a bordurilor echipate, analiza integrității semnalelor. S-a reușit ca, într-un timp relativ scurt, să se pună la dispoziția cadrelor didactice, studenților precum și specialiștilor din întreprinderile de profil interesate in dezvoltarea de produse electronice competitive instrumente soft performante. Dupa 1995 au fost organizate anual sau bianual **workshopuri (peste 50) cu tematica orientată spre aplicativ** la care au participat alături de cadre didactice din mediul universitar bucureștean colegi din Iași, Cluj, Timișoara, Pitești, Galați, Suceava, precum și specialiști din institute de cercetare de profil (Institutul de Cercetare Dezvoltare al Armatei, Institutul pentru Tehnologii Avansate, Institutul pentru Hidraulică), firme cu capital de stat sau privat (Electromagnetica, NEI, Electronica, ANTRICE, Electromagnetica Goldstar, IRMES- Sibiu, Electroputere Craiova, IAR Brașov, ș.a.). A fost organizat Seminarul Internațional de Informatică și Tehnologie pentru fabricarea Modulelor Electronice- SIITME, care a ajuns deja la a XX-a ediție. In mod constant **promoveaza in Romania problematica packagingului electronic** atat prin organizarea de conferinte internationale in tara cat si prin prezentarea de prelegeri invitate la universitati din tara (Iasi, Pitesti, Timisoara,etc). De altfel, prin contactele foarte bune pe care le are in strainatate in domeniul mai sus mentionat, faciliteaza legatura intre specialistii din tara si cei din strainatate.

• In vederea stimulării studenților pentru a deveni adevărați profesioniști ai domeniului, a fost inițiat concursul profesional de CAD in domeniul modulelelor electronice, concurs la care au acces toți studenții care au cunoștințe în domeniul proiectării asistate. Concursul a ajuns la ediția a XXIII-a și se bucură de interes în rândul studenților. La recenta editie organizata de Universitatea Politehnica din Timișoara au fost prezenti finaliști (40 de finaliști) din treisprezece centre universitare importante. Ediția a XVIII a fost prima ediție a concursului internațional privind proiectarea structurilor de interconectare a modulelor și microsystemelor electronice. Opinii extrem de pozitive la adresa evenimentului ce s-a desfășurat la Galați au avut persoane a căror reputație în domeniul packagingului electronic este recunoscută pe plan mondial. Atât profesorul Nihal Sinnadurai (UK) cât și profesorul Zsolt Illyefalvi – Vitez (Hu) au avut numai cuvinte de apreciere privitor la această manifestare, poate singura pe plan mondial. De altfel, prof. Sinnadurai, care reprezintă societatea IEEE-CPMT (Component Packaging & Manufacturing Technology) a solicitat și a obținut din partea Președintelui societății, Bill Chen, acordarea câștigătorului ediției TIE 2009 unui grant de membru CPMT pe durata unui an de zile.